

股票代號：3585



聯致科技股份有限公司
Advance Materials Corporation

114 年度
年報

中華民國一一五年三月二十五日刊印

年報查詢網址：

金管會指定之資訊申報網站：<https://mops.twse.com.tw/>

公司揭露年報相關資料：<http://www.amcorp.com.tw/>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人

姓名及職稱：蘇連芳 財會主管

電話：(03) 324-6000 ext. 5528

電子郵件信箱：IR@amcorp.com.tw

代理發言人

姓名及職稱：陳福龍 總經理

電話：(03) 431-5168 ext. 7268

電子郵件信箱：IR@amcorp.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

單位	地址	電話
總公司	桃園市蘆竹區南山路二段 498 之 2 號	(03) 324-6000
南山廠	桃園市蘆竹區南山路二段 498 之 2 號	(03) 324-6000
楊梅廠	桃園市楊梅區新農街二段 209 巷 168 號	(03) 431-5168

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市信義路四段 236 號 3 樓

電話：(02)2326-8818

網址：<https://www.honsec.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：林雅慧會計師、王崧澤會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

電話：(02)2729-6666

網址：<https://www.pwc.com>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

無。

六、公司網址：<http://www.amcorp.com.tw>

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	8
三、公司治理運作情形.....	11
四、簽證會計師公費資訊.....	25
五、更換會計師資訊.....	25
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	25
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	26
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	27
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	27
參、募資情形.....	28
一、資本及股份.....	28
二、公司債辦理情形.....	31
三、特別股辦理情形.....	31
四、海外存託憑證辦理情形.....	31
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	31
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：.....	31
七、資金運用計劃執行情形：.....	31
肆、營運概況.....	32
一、業務內容.....	32
二、市場及產銷概況.....	38
三、從業員工資料.....	43
四、環保支出資訊.....	43
五、勞資關係.....	44
六、資通安全管理.....	45
七、重要契約.....	46
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	47
一、財務狀況.....	47
二、財務績效.....	48
三、現金流量.....	49
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	49

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	50
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估	50
七、其他重要事項	53
陸、特別記載事項	54
一、關係企業相關資料	54
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	56
三、其他必要補充說明事項	56
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	56

壹、致股東報告書

各位敬愛的股東女士先生們：

(一) 114 年度營業結果

1. 營業計畫實施成果(合併報表)

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	114 年度	增減變動	
	金額	金額	金額	%
營業收入	375,626	432,102	56,476	15
營業毛利	15,077	30,780	15,703	104
營業損益	-79,320	-54,368	24,952	31
營業外收入及支出	193,646	17,191	-176,455	-91
稅前淨利	114,326	-37,177	-151,503	-133
本期淨利(損)	64,411	-39,395	-103,806	-161

2. 預算執行情形

本公司 114 年度並未對外公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

3. 財務收支及獲利能力分析

年度 項目	113 年度	114 年度
	資產報酬率(%)	5.04
股東權益報酬率(%)	5.85	-3.52
營業利益佔實收資本比率(%)	-7.1	-4.87
稅前純益佔實收資本比率(%)	10.24	-3.33
純益率(%)	17.15	-9.12
稅後每股盈餘(元)	0.49	-0.35

(二) 115 年度營業計畫概要

1. 經營方針

- I. 鞏固並擴大既有客戶與市場之營業額
- II. 積極開拓新客戶、推廣新產品(如玻璃基板之化學品材料及被動元件應用材料)
- III. 提升產出效率與品質，降低 C 級與不良品金額
- IV. 減少原料、物料、成品之呆滯庫存

2. 預期銷售數量及其依據

本公司持續著重在不流膠 PP、玻璃基板材料、乾膜防焊、純膠(含 5G 純膠)及被動元件應用材料等產品為營運的主軸。115 年銷售計畫係依據合約、最近銷售狀況及市場變化與客戶營運展望之情況預估訂定。

3. 重要之產銷政策

以滿足客戶少量多樣及特定生產技術之需求，極力配合客戶要求之交期，以利基產品為導向積極開拓市場，為了落實上述目標，本公司推行之重要產銷政策如下：

I. 行銷策略：

- A. 市場導向開發：緊隨 AI 運算與高速通訊趨勢，優先投入資源於玻璃基板應用材料與高頻低損耗材料，維持技術領先地位。
- B. 技術協同開發：採取「技術前導型行銷」，與客戶共同研發、開發符合特定生產技術需求的材料以提升客戶黏著度。
- C. 深化客戶合作：透過技術服務團隊即時進駐客戶端，解決現場加工技術難題，將產品銷售轉化為完整的解決方案提供。

II. 生產政策：

- A. 彈性化生產管理：建立快速換線機制，以縮短多變市場下的客戶認證週期。
- B. 製程精進與降本：優化化學品材料配方，協助客戶降低生產損耗與製程效率。
- C. 供應鏈韌性：建立策略性安全庫存與多元供應體系，以因應地緣政治可能導致的原料短缺風險。

(三) 未來公司發展策略

展望未來，本公司將持續秉持利基導向，以「高階技術領先、精實營運」為策略主軸。將集中研發資源於 AI 運算所需的玻璃基板之化學品材料與 5G/6G 高頻通訊材料。並深化與客戶的協同研發關係。透過精實生產管理確保交期精準度與資本使用效率，創造經濟價值，達成永續經營之目標。

(四) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 同業競爭：

在「綠色通膨」與能源、人工成本全面上升的環境下，同業競爭的本質已從單純的「規模與速度」轉向「技術深耕、營運韌性與永續數據」的全面競賽。本公司藉由資源整合及提升專案管理效能以提供客戶製程優化、配合開發新產品，進而降低客戶與本公司之營運風險及成本，提升本公司之創新價值，在同業賽局中避免陷入單純的價格戰，

2. 法規環境

本公司 114 年持續執行環保作業相關 SOP 以提升並改善作業環境，防止對環境之汙染。

3. 總體經營環境之影響

114 年全球經濟維持約 3.0% 的穩健增長，但區域衝突頻仍、政經局勢動盪、保護主義升溫及 AI 帶來的價值鏈重塑，使企業面臨高度不確定性。面對科技浪潮與不確定性成為常態的時代，本公司以人機協作為前提，提昇企業專業的價值，與客戶合作開發新應用領域之產品材料、擴大附加價值高之高階利基產品及營收比率，以期增進整體經營效益。

衷心感謝所有的股東對本公司的支持與愛護，聯致將更積極更努力以創造更好的成績來提升股東價值。

最後謹祝各位

身體健康，萬事如意

董事長



總經理



會計主管



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事：

(1)董事資料

115年3月23日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公 司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數 (仟 股)	持 股 比 率	股數 (仟 股)	持 股 比 率	股數 (仟 股)	持 股 比 率	股數 (仟 股)	持 股 比 率			股數 (仟 股)	持 股 比 率	職稱	
董事長	台灣	欣興電子(股) 公司	男 70- 75	114.05.22	3	93.04.29	27,197	19.58%	27,197	19.58%	-	-	-	-	淡江大學化學系 華得電子-廠長	註1	-	-	-	-
		代表人：李長明		114.05.22		99.06.24	-	-	-	-	58	0.05%	-	-						
董事	台灣	欣興電子(股) 公司	男 50- 55	114.05.22	3	93.04.29	27,197	19.58%	27,197	19.58%	-	-	-	-	中國文化大學應用化學碩士	欣興電子(股)-資深副總經理 聯能科技(深圳)(有)-董事 PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) Ltd.-董事	-	-	-	-
		代表人：張世杰		114.05.22		105.06.23	-	-	-	-	-	-	-	-						
董事	台灣	陳福龍	男 60- 65	114.05.22	3	105.06.23	1,726	1.27%	1,608	1.44%	1	-	-	-	Case Western Reserve University 高分子博士 工研院材料所組長	註2				
獨立 董事	台灣	陳壽安	男 80- 85	114.05.22	3	100.06.23	-	-	-	-	-	-	-	-	註3	清華大學榮譽講座教授	-	-	-	-
獨立 董事	台灣	陳文川	男 65- 70	114.05.22	3	96.12.05	-	-	-	-	-	-	-	-	註4	無	-	-	-	-
獨立 董事	台灣	黃財旺	男 65- 70	114.05.22	3	102.06.21	-	-	-	-	-	-	-	-	註5	無	-	-	-	-

註1：欣興電子(股)-資深顧問、鈺順材料(股)-董事長、Willy Holding Ltd.-董事長、AMC HOLDING Ltd.-董事長、蘇州聯致科技(有)-董事長及Unimicron Japan-代表取締役社長。

註2：聯致科技(股)-總經理、鈺順材料(股)-董事暨執行長、蘇州聯致科技(有)-董事兼總經理、AMC MATERIALS Ltd.-董事長、東莞市聯致電子科技(有)-董事長及永眾科技(股)-董事。

註3：美國華盛頓大學化工系博士、清華大學前瞻物質基礎與應用科學中心主任、清華大學化工系主任、W. R. Grace & Co., Research Scientist、UniRoyal Inc., Senior Chemist。

註4：東吳大學會計系、台灣金山電子-產品開發副總經理、台灣金山電子-財務副總經理、同泰電子科技-財務處協理、惟達電公司-總管理處副總經理、聲寶公司-成本會計、金山電子(股)-薪酬委員。

註5：淡江大學電子工程系、陞達半導體(股)-董事長暨總經理、聯華電子-歐洲分公司總經理、聯陽半導體-執行副總經理、台灣凱為半導體科技(有)公司-董事長暨總經理、鈺偉科技(股)-薪酬委員、笙泉科技(股)-董事、矽統科技(股)-獨立董事暨薪酬委員。

(2)法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例%
欣興電子股份有限公司 (註：持股基準日為民國 114 年 7 月 14 日除息基準日停止過戶日)	聯華電子股份有限公司	13.00%
	富邦人壽保險股份有限公司	3.30%
	國泰人壽保險股份有限公司	2.31%
	花旗託管新加坡政府投資專戶	1.99%
	新制勞工退休基金	1.69%
	中華郵政股份有限公司	1.58%
	焱元投資股份有限公司	1.50%
	南山人壽保險股份有限公司	1.31%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.23%
摩根託管梵加德新興市場股票指數	1.10%	

(3)法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東	持股比例%
聯華電子股份有限公司 (註：持股基準日為民國 114 年 6 月 30 日，此為民國 114 年除息基準日)	群益台灣精選高息 E T F 基金專戶	6.47%
	台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金專戶	5.34%
	迅捷投資(股)公司	3.52%
	美商摩根大通託管聯華電子海外存託憑證專戶	3.24%
	元大台灣高股息基金專戶	2.74%
	台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶	2.69%
	矽統科技(股)公司	2.12%
	台灣人壽保險(股)公司	1.74%
	焱元投資(股)公司	1.54%
	新制勞工退休基金	1.48%
富邦人壽保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司	100%
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司	100%
中華郵政股份有限公司	交通部	100%
焱元投資(股)公司 (註：持股基準日為 114 年 12 月 31 日)	矽品精密工業股份有限公司	27.94%
	聯華電子股份有限公司	26.78%
	京元電子股份有限公司	14.55%
	欣興電子股份有限公司	11.64%
	中強光電股份有限公司	11.06%
	矽格股份有限公司	5.70%
迅捷投資股份有限公司	2.33%	

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東	持 股 比 例 %
南山人壽保險股份有限公司 (註：中華民國 114 年 6 月)	潤成投資控股股份有限公司	89.55%
	潤華染織廠股份有限公司	1.34%
	杜英宗	1.16%
	潤泰興股份有限公司	0.97%
	潤泰創新國際股份有限公司	0.23%
	潤泰全球股份有限公司	0.21%
	元新投資股份有限公司	0.16%
	潤泰租賃股份有限公司	0.12%
	吉品投資股份有限公司	0.11%
	朋城股份有限公司	0.09%

(4) 董事專業資格及獨立董事資訊揭露：

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
欣興電子(股)公司 代表人： 李長明	現任本公司董事長、欣興電子資深專案特助及多家上市櫃公司法人董事代表，並擔任台灣電路板協會 TPCA 理事長，致力於 PCB 產業相關，擁有專業領導、營運管理及策略規畫能力，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	-
欣興電子(股)公司 代表人： 張世杰	現任欣興電子副總經理，擁有專業領導、營運管理及策略規畫能力，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	-
陳福龍	Case Western Reserve University 高分子博士畢業，工研院材料所組長，具備公司治理及產業相關專業領域經驗專才，能適時提供研發技術上所需之專業意見，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	-
陳壽安	美國華盛頓大學化工系博士畢業，現任清華大學化學工程學系榮譽講座教授，學術領域高分子科學與工程有助提供公司研發專業諮詢，其具有五年以上公司業務所須相關科系院校講師工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事之一。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取之報酬金額。	-
陳文川	畢業於東吳大學會計系，曾任台灣金山電子財務副總經理及同泰電子科技財務處協理等職務，具有會計、危機處理能力之工作經驗，在執行獨立董事及審計委員會職權時，其財務會計之專長，可以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能，現任福納米應材-副總經理，且具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事之一。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取之報酬金額。	-
黃財旺	畢業於淡江大學電子工程學士，曾任陞達半導體(股)公司董事長暨總經理、台灣凱為半導體科技董事長暨總經理，具有危機處理能力之工作經驗，在執行獨立董事及審計委員會職權時，其財務會計之專長，可以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能，現任矽統科技(股)獨立董事暨薪酬委員，且具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事之一。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取之報酬金額。	-

(5)、董事會多元化及獨立性：

- A. 董事會多元化:敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，並以以下二大面向為標準：

- a、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- b、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：

- a、營運判斷能力。
- b、會計及財務分析能力。
- c、經營管理能力。
- d、危機處理能力。
- e、產業知識。
- f、國際市場觀。
- g、領導能力。
- h、決策能力。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	性別	國籍	兼任本公司員工	年 齡				獨立董事任期年資			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	國際市場觀	風險管理
				50至55	61至70	71至75	81至85	3年以下	3至9年	9年以上							
欣與電子(股)公司 代表人:李長明	男	中華民國				√					√	√	√			√	√
欣與電子(股)公司 代表人:張世杰	男	中華民國		√							√	√	√			√	√
陳福龍	男	中華民國	√		√						√	√	√			√	√
陳壽安	男	中華民國					√			√			√			√	
陳文川	男	中華民國			√					√	√	√	√	√		√	√
黃財旺	男	中華民國			√					√	√	√	√	√		√	√

綜上，本公司現任董事會由6位董事組成，包含董事3席與獨立董事3席，具員工身份之董事占比為17%，獨立董事占比為50%、女性董事占比為0%，3位獨立董事任期年資在9年以上。

成員具備財會、管理及本公司行業別專業領域專家，每位董事及獨立董事皆有其專門之領域，董事3席包括長於經營管理、領導決策、且具產業知識及國際市場觀之專業領域，另3位獨立董事則分別長於財會、稅務及講授教學，對本公司各項業務指點良多。

B. 董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本公司第十屆董事會成員目前為6名，其中獨立董事3名。獨立董事以不得少於3人且不少於董事席次1/5(含)以上為目標，已有3席獨立董事且佔董事席次達3/6；董事兼任公司員工以不超過董事席次1/2(含)為目標，目前僅1席董事兼任員工身分；另董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係。綜合前述，獨立性目標皆已達成。

(二)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：

115年3月23日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數(仟股)	持股比率	股數(仟股)	持股比率	股數(仟股)	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	台灣	陳福龍	男	87/10/1	1,608	1.44%	1	0.00%	-	-	Case Western Reserve University 高分子博士 工研院材料所組長	蘇州聯致科技有限公司-董事、總經理 鈺順材料(股)-執行長兼董事 AMC MATERIALS LIMITED-董事長、 東莞市聯致電子科技有限公司-董事長 永眾科技(股)-董事	-	-	-	-
營運支援部協理	台灣	蘇連芳	男	91/11/1	0	0	0	0	-	-	元智大學管理研究所碩士 欣興電子(股)公司 柏拉圖電子(股)公司	蘇州聯致科技有限公司董事	-	-	-	-

(三) 董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：不適用。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣仟元；仟股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註5)				兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%) (註5)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D) (註4)		薪資、獎金及特支費等(E) (註6)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)				本公司	財務報表內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司							
董事長	欣興電子(股)公司 代表人：李長明	-	-	-	-	-	-	20	20	-0.05%	-0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05%	-0.05%	-	
董事	欣興電子(股)公司 代表人：張世杰	-	-	-	-	-	-	20	20	-0.05%	-0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05%	-0.05%	-	
董事	欣鉅興(股)公司 代表人：顏立盛							10	10	-0.02%	-0.02%									-0.02%	-0.02%	-	
董事	陳福龍	-	-					20	20	-0.05%	-0.05%	2,217	2,217	108	108					-	-5.93%	-5.93%	-
獨立董事	陳壽安	480	480	-	-	-	-	20	20	-1.28%	-1.28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.28%	-1.28%	-	
獨立董事	陳文川	480	480	-	-	-	-	20	20	-1.28%	-1.28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.28%	-1.28%	-	
獨立董事	黃財旺	480	480	-	-	-	-	20	20	-1.28%	-1.28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.28%	-1.28%	-	

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

考量獨立董事參與薪資報酬委員會、審計委員會及董事會之討論，對公司營運參與程度及貢獻價值高，按月給付之固定酬勞。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：本公司114年度個體及合併報表之稅後虧損為新台幣39,199仟元及39,395仟元，故以個別揭露，無須填列酬金級距表。

註2：係114年度支付獨立董事之報酬。

註3：係114年度虧損撥補案股東會前經第十屆第四次董事會通過擬不配發董事酬勞。

註4：係114年度支付董事之相關業務執行費用。

註5：係114年度個體報表之稅後純益。

註6：係擔任總經理薪資。

(二)監察人之酬金：不適用。

(三)總經理、副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	薪資(A)(註1)		退職退休金(B)(註2)		獎金及特支費(C)(註3)		員工酬勞金額(D)(註4)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註5)(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	陳福龍	1,815	1,815	108	108	402	402	0	0	0	0	2,325 -5.94%	2,325 -5.94%	0

註1：係114年度支付之報酬。

註2：係114年度提撥至政府機關之金額。

註3：係114年度年節獎金及汽車租金等。

註4：係114年度虧損撥補案股東會前經第十屆第四次董事會通過擬不配發董事酬勞。

註5：係114年度之稅後虧損新台幣39,199仟元。

註6：本公司目前並未設置副總經理。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元/仟股

	職稱	姓名	現金金額 (註A)	股票金額 (註A)	總計	總額占稅後純益之比例 (註B)(%)
經理人	總經理	陳福龍	0	0	0	-0%
	營運支援部協理	蘇連芳				

註A：係114年度虧損撥補案股東會前經第十屆第四次董事會通過擬不配發員工酬勞。

註B：係114年度之稅後虧損新台幣39,199仟元。

(五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純(損)益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(1)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金資訊：

單位：新台幣仟元

人員	113年度				114年度			
	酬金金額		佔稅後純益比例%(註)		酬金金額		佔稅後純益比例%(註)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	1,575	1,575	2.86%	2.86%	1,560	1,560	-3.98%	-3.98%
總經理	2,293	2,293	4.16%	4.16%	2,217	2,217	-5.66%	-5.66%

註：本公司暫無設置副總經理。

本公司113年度稅後純益為新台幣55,108仟元，114年度稅後純損為新台幣39,199仟

元，113 年度及 114 年度董事酬金主係支付獨立董事之報酬及董事車馬費，兩期金額差異不大；總經理酬金主係每月經常性薪資、年終獎金及汽車租金等，兩期金額差異不大。

(2) 說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司爰依據證券交易法第十四條之六及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。

本公司給付酬金之政策、標準與組合及訂定酬金之政策及制度主要係經本公司薪酬委員會予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。並經董事會決議後據以作為本公司之人事規章有關辦法執行依據；獨立董事之報酬，係提請董事會訂定，並不參與盈餘分派之董事酬勞分派；而盈餘分派之董事酬勞及員工酬勞係依據本公司章程規定提撥，經薪酬委員會通過並提交董事會核准後，再呈股東會同意，其中董事酬勞依非獨立董事人數平均分派，員工酬勞除參考同業水準及產業競爭外，公司整體之營運績效與獲利，更是分派時之重要依據，故酬金發放與經營績效之關聯性係屬正相關。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

最近年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備註
董事長	欣興電子(股)公司 代表人：李長明	5	0	100%	
董事	欣興電子(股)公司 代表人：張世杰	3	2	60%	
董事	陳福龍	5	0	100%	
董事	欣鉅興科技(股)有限公司 代表人：顏立盛	3	1	60%	114.10.20 辭任
獨立董事	陳壽安	5	0	100%	
獨立董事	陳文川	5	0	100%	
獨立董事	黃財旺	5	0	100%	

其他應記載事項：

1、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第14條之3所列事項：無。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決議事項：無。

2、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

期別 董事會日期	議案內容	利益迴避 董事姓名	迴避 原因	參與表決情形
第九屆 第十二次 2/20/2025	擬提名本公司第十屆董事 7 席(含獨立董事 3 席)候選人名單案。	李長明 張世杰 陳福龍 顏立盛 陳文川 陳壽安 黃財旺	董事 利益 迴避	左列董事因此議案與其自身有利害關係，採逐一迴避離席不行使表決權，其餘出席董事無異議通過。
	說明第十屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之理由。	陳文川 陳壽安 黃財旺	董事 利益 迴避	左列董事因此議案與其自身有利害關係，故迴避離席不行使表決權，其餘出席董事無異議通過
第十屆 第三次 (12/18/2025)	本公司一一五年度擬實施之董事及經理人之各項薪資報酬項目案，提請核議。	陳文川 陳壽安 黃財旺	董事 利益 迴避	左列董事因此議案與其自身有利害關係，故迴避離席不行使表決權，其餘出席董事無異議通過
	本公司為提供經理人用車補助案。	陳福龍	董事 利益 迴避	左列董事因此議案與其自身有利害關係，故迴避離席不行使表決權，其餘出席董事無異議通過
	本公司一一四年度經理人年終獎金發放案。	陳福龍	董事 利益 迴避	左列董事因此議案與其自身有利害關係，故迴避離席不行使表決權，其餘出席董事無異議通過

3. 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：不適用。

4、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1)本公司目前董事會職能應屬健全，並足以因應目前公司治理之需求。
- (2)本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會，以健全監督功能及強化管理機能，落實公司治理。
- (3)本公司董事會成員設置7席，其中3席獨立董事；全體董事採候選人提名制選任。

(二)審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會3次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備註
獨立董事	陳壽安	3	0	100%	
獨立董事	陳文川	3	0	100%	
獨立董事	黃財旺	3	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(1)證券交易法第14條之5所列事項：

期別 董事會日期	議案內容	獨立董事 意見	公司對獨立董 事意見之處理	是否至少一席 獨立董事親自出席
第四屆 第十一次 (2/20/2025)	擬通過本公司一一三年度「內部控制聲明書」案。	無意見	不適用	是
	本公司民國一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，擬經審計委員會查核，送請董事會通過後，報請股東會承認案。	無意見	不適用	是
第五屆 第一次 (7/24/2025)	本公司一一四年第二季合併財務報表會計師核閱稿本案。	無意見	不適用	是
	擬清算解散境外薩摩亞子公司 AMC HOLDING LIMITED 案。	無意見	不適用	是
	擬清算解散境外薩摩亞子公司 WILLY HOLDING LIMITED 案。	無意見	不適用	是

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (1)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中做內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，114年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (2)本公司簽證會計師定期與審計委員會報告財務報表查核或核閱結果，及其他相關法令要求之溝通事項，本公司審計委員會與會計師溝通狀況良好。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		√	公司目前尚未訂定公司治理實務守則，日後將考量現況增訂。	同摘要說明
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√ √ √ √		(一) 本公司設有股務單位及發言人、代理發言人制度，統籌處理股東建議或糾紛等問題。 (二) 本公司能掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定揭露主要股東相關資訊。 (三) 本公司設有公共安全單位，且依據本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」及「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」，與集團間有良好之聯繫管道，能有效控管公司風險。 (四) 本公司訂定防範內線交易之管理作業，以規範公司經理人、董事、受僱人，避免其違反內線交易之情事。	尚無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化方針政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估且	√ √ √		(一) 本公司設董事五~九人，任期三年，自114年採候選人提名制度，均由股東會就候選人名單選任之，本公司已設置3席獨立董事其背景各有財經專業、大學教授及與本公司業務所需之相關經驗。 (二) 其他各類功能性委員會視公司未來需要設置。 (三) 本公司設有薪酬委員會，由薪酬委員會評估董事績效及報酬合理性。	同摘要說明

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司之簽證會計師隸屬於國際四大會計師事務所之一之在台會員事務所，對於委辦事項與其本身有直接或間接利害關係者予以迴避，充分堅守公正、嚴謹及誠實超然獨立之精神。	
四、上市櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？		✓	公司由財會課負責公司治理相關事務及負責提供董事、審計委員會委員執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。	同摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司與關係人間之溝通，依據本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」及「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」規定辦理，並於公司網站設置利害關係人專區以妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	尚無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委託宏遠證券股份有限公司辦理股東會事務。	尚無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限	✓ ✓		(一)本公司設有網站，介紹公司狀況及產品，並依規定於公開資訊觀測站揭露相關財務等資訊。 (二)由專人負責公開資訊之網路相關資訊申報作業，並設有發言人及代理發言人制度，設發言人一人，代理發言人一人。 (三)本公司均依照相關規定期限內完成申報。	同摘要說明

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？				
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	√		<p>(一)本公司均依照相關法令訂定人事規章，以保障員工權益；並藉由職工福利委員會之設立，依法提撥職工福利金、員工退休金，讓員工享有進修、訓練、員工旅遊、定期健康檢查等各項福利措施，以達關懷員工之效。</p> <p>(二)本公司設置發言人制度由專人與投資者及利害關係人保持良好溝通並提供必要資訊。</p> <p>(三)董事進修之情形：本公司不定期提供董事需注意之相關法規資訊。</p> <p>(四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有環境、公共安全等相關作業標準書，並已通過ISO14001等認證，相關機構定期至本公司進行各項稽核，在公司治理運作上之執行情形良好。</p> <p>(五)客戶政策之執行情形：本公司對產品有嚴格之品保政策，有客服部門專責提供良好客戶服務，以及解決發生之問題。</p> <p>(六)董事購買責任保險之情形：已為董事購買責任保險。</p>	尚無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：不適用。				

(四)公司如有設置薪酬委員會者或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料：

114年3月25日

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 (召集人)	陳文川	請參閱第7頁附表一 董事資料揭露之相關 內容	(1)為獨立董事，符合獨立性情形，包括但 不限於本人、配偶、二親等以內親屬未 擔任本公司或其關係企業之董事、監察 人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用 他人名義)未持有公司股份數。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董 事、監察人或受僱人。 (4)未有最近2年提供本公司或其關係企業 商務、法務、財務、會計等服務所取之 報酬金額。	0
獨立董事	陳壽安			0
獨立董事	黃財旺			0

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊：

- 1.本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
- 2.本屆委員任期：114年5月22日至117年5月21日，最近年度薪資報酬委員會開會2次
(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	陳文川	2	0	100%	
委員	陳壽安	1	0	50%	
委員	黃財旺	2	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因):無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		√	本公司尚無制訂永續發展之治理架構之相關政策或制度，但是企業社會責任之維護由行政及工務共同推動。	如左列之說明。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	√		本公司頒訂AMC 0102經營管理作業程序，針對與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略以提升經營管理績效達成公司之目標。	尚無重大差異。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		本公司設置有資源回收箱，對生產過程中產生之廢棄物進行分類回收，並向員工宣導資源回收之社會責任。	尚無重大差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		本公司皆委由合格之廠商，對分類回收之廢棄物進行回收再利用之處理作業對使用污染性較高能源之設備進行修改，由重油或柴油修改為瓦斯，以降低污染性。	尚無重大差異。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	√		本公司全廠皆有空調溫度控制，以達成節能的目標。	尚無重大差異。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		√	對使用污染性較高能源之設備進行修改，以達成節能減碳之效用	如左列之說明。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		公司依據勞基法等相關法規，訂定AMC 1901人事任用作業程序、AMC 1902教育訓練作業程序，並設有勞資會議，以維護員工相關權益。	尚無重大差異。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等）並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司配合法定調整員工基本薪資及休假制度，並依公司經營績效成果，訂定年後績效獎金發放方式，並依規章進行員工分紅提撥。	尚無重大差異。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司定期進行工作環境檢查，並定期對員工進行安全與健康之教育訓練，且每年提供員工健康檢查，以維護員工之安全與健康	尚無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		AMC 1902教育訓練作業程序其中包含新進人員及在職人員各項教育訓練規定，另有AMC 1907升等辦法，訂有各職等、各級主管應具備之訓練。	尚無重大差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		為提升客戶服務的滿意度，本公司訂有「客訴處理」，明訂客戶對產品申訴、抱怨、提案或不滿意時之處理流程，以解決客戶的問題。公司產品之標示係依主管機關及國際準則規定辦理	尚無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司訂有「採購管理程序書」，採購時將依規定從合格供應商優先購買，並進行詢、比、議價程序，以確保採購價格之合理性。此外，供應商有涉及違反企業社會責任，將主動停止與該公司之往來。	尚無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司尚未編製企業社會責任報告書。	如左列之說明。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司尚未訂定永續發展守則，惟本公司已依公司法及證期局相關法規進行公司治理，並已涵蓋主要治理原則。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>(一)本公司訂定「誠信經營守則」及「董事、經理人道德行為準則」，規定本公司之董事、經理人、受僱人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案，並提供適當管道供董事、經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(二)本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益，並針對新雇用之員工進行職前教育訓練。</p> <p>(三)本公司及其董事、經理人、受僱人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。</p>	尚無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明誠信行為條款？</p>	<p>√</p>		<p>(一)本公司於商業往來之前，先考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，與他人簽訂制重</p>	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(責)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>大之契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>(二) 本公司由稽核室、營運支援處推動誠信經營，為維持廉潔風氣及經營績效，公司訂定「同仁廉潔守則」，在新進員工到職時，皆要求員工詳讀及簽署，並提供檢舉專線供員工檢舉違反廉潔守則情形。</p> <p>(三) 本公司嚴禁員工對於經營或監督之業務，利用職務之便，行直接或間接圖利之行為、以獲取不當利益或最其他舞弊情事，未經公司事前核可，全體同仁不得投資與本身工作有利益衝突、且未透過公開市場之投資行為。</p> <p>(四) 為落實誠信經營，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，並由內部稽核人員，定期稽核相關制度與運作情況，確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>(五) 本公司定期舉辦教育訓練，並配合集團課程，鼓勵員工踴躍參與課程。</p>	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>本公司「誠信經營守則」中訂有檢舉與獎懲原則，員工可透過電話或信件向行政部門主管檢舉相關違反誠信經營規定，並規定對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密措施。</p>	尚無重大差異
四、加強資訊揭露				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	√		公司於公開資訊觀測站、年報、網站揭露公司誠信經營及其他重大資訊。	尚無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂有「誠信經營守則」，目前公司內部運作與守則內容並無重大差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司對於首次進行商業往來之廠商，告知其誠信經營之立場，針對重大工程及設備購置案，要求廠商簽署供應商廉潔承諾書，若供應商違反相關條款經查證屬實，將自供應商名單中除名。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(八)內部控制執行狀況

1. 內部控制聲明書

聯致科技股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：115年2月12日

本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊及溝通，及 5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一五年二月十二日董事會通過，出席董事 6 人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

聯致科技股份有限公司

董事長：李長明



總經理：陳福龍



2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 一一四年度股東常會重要決議：

說明：下列議案均經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- (1)承認本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- (2)承認本公司一一二年度虧損撥補案。
- (3)選舉本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)案。
- (4)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
- (5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2. 一一四年度董事會重要決議：

說明：下列議案除有涉及利益迴避之相關人員進行迴避不參與決議外，均經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

- (1)擬通過本公司一一三年度「內部控制聲明書」案。
- (2)本公司民國一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經審計委員會查核，擬請董事會通過後，報請股東會承認案。
- (3)本公司一一三年度虧損撥補案。
- (4)本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- (5)本公司第十屆董事改選，暨董事候選人提名及受理相關事宜案。
- (6)擬提名本公司第十屆董事7席(含獨立董事3席)候選人名單案。
- (7)說明第十屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之理由。
- (8)擬請股東會解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
- (9)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (10)召開本公司一一四年股東常會案。
- (11)本公司114年度股東常會變更開會地點案。
- (12)推選本公司第十屆董事長案，提請選任。
- (13)委任本公司第六屆薪資報酬委員會成員案。
- (14)本公司一一四年度下半年度營業預算修正案。
- (15)本公司為配合營運週轉及避險需求，擬向中國信託商業銀行辦理短期綜合額度及金融交易額度之續約申請。
- (16)擬清算解散境外薩摩亞子公司 AMC HOLDING LIMITED 案。
- (17)擬清算解散境外薩摩亞子公司 WILLY HOLDING LIMITED 案。
- (18)本公司一一五年度擬實施之董事及經理人之各項薪資報酬項目案。
- (19)本公司為提供經理人用車補助案。
- (20)本公司一一四年度經理人年終獎金發放案。
- (21)本公司一一五年度內部稽核計畫案。
- (22)本公司一一五年度營業預算案。
- (23)本公司為配合營運需求，擬向合作金庫銀行辦理短期綜合額度之續約案。

3. 一一五年度董事會重要決議(截至115年2月12日)

說明：下列議案均經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

- (1)擬通過本公司一一四年度「內部控制聲明書」案。
- (2)本公司民國一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經審計委員會查核，擬請董事會通過後，報請股東會承認案。
- (3)本公司一一四年度虧損撥補案。
- (4)本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- (5)補選本公司第十屆董事一席案。
- (6)提名本公司第十屆董事補選候選人名單案。
- (7)提請股東會解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制案。
- (8)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
- (9)召開本公司一一五年股東常會案。
- (10)訂定股東會提案權相關事宜案。
- (11)訂定股東會受理股東提名相關事宜案。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無。

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	林雅慧	王崧澤	114.01.01~ 114.12.31	1,740	410	2,150	

註：非審計公費包含稅務簽證費 310 仟元及兼營營業人營業稅採直接扣抵法簽證費 100 仟元。

- (一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。
- (二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊

無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者

無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：仟股

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 3 月 23 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	欣興電子股份有限公司 代表人：李長明	8,022	—	—	—
		—	—	—	—
董事	欣興電子股份有限公司 代表人：張世杰	8,022	—	—	—
		—	—	—	—
獨立董事	陳壽安	—	—	—	—
獨立董事	陳文川	—	—	—	—
獨立董事	黃財旺	—	—	—	—
董事暨總經理	陳福龍	—	—	(118)	—
財務兼會計主管	蘇連芳	(85)	—	—	—

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115年3月23日

姓名	本人		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	持有股份		股數 (仟股)	持股 比率	股數 (仟股)	持股 比率	名稱	關係	
	股數 (仟股)	持股 比率							
欣興電子股份有限公司 代表人:簡山傑	27,197	24.35%	-	-	-	-	欣揚投資股份有限公司	欣興電子之子公司	
	0	0.00%	-	-	-	-			
欣揚投資股份有限公司 代表人:蘭庭	7,782	6.97%	-	-	-	-	欣興電子股份有限公司	欣興電子之子公司	
	0	0.00%	-	-	-	-			
陳淑珍	2,771	2.48%	-	-	-	-			
鄭德燦	2,457	2.20%	-	-	-	-			
余明洋	2,224	1.99%	-	-	-	-			
陳福龍	1,608	1.44%	-	-	-	-			
永豐餘建設開發股份有限公司 代表人:駱秉正	1,542	1.38%	-	-	-	-			
	0	0.00%	-	-	-	-			
志聖工業股份有限公司 代表人:梁茂生	910	0.81%	-	-	-	-			
	0	0.00%	-	-	-	-			
曾子章	893	0.80%	437	0.39%	-	-			
謝立帆	885	0.79%	-	-	-	-			

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
WILLY HOLDINGS LIMITED	48,106	100.00%	0	0.00%	48,106	100.00%
AMC MATERIALS LIMITED	6,500	100.00%	0	0.00%	6,500	100.00%
鈺順材料股份有限公司	2,500	41.67%	0	0.00%	2,500	41.67%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

1、股本來源

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額(元)	股數	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他(現增核准文號)
87.09	10	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	設立資本	無	87.09.15 經八七商 128588 號
88.07	12	120,000,000	1,200,000,000	65,000,000	650,000,000	現金增資 35,000 仟股	無	88.07.15 經八八商 125589 號
90.01	15	120,000,000	1,200,000,000	95,000,000	950,000,000	現金增資 30,000 仟股	無	90.01.17 經(0九0) 商 09001005100 號
95.04	15	120,000,000	1,200,000,000	105,000,000	1,050,000,000	現金增資 10,000 仟股	無	95.04.25 經授商字第 09501074870 號
95.10	10	200,000,000	2,000,000,000	110,400,000	1,104,000,000	盈餘轉增資 5,400 仟股	無	95.10.04 經授商字第 09501225620 號
96.08	10	200,000,000	2,000,000,000	115,238,300	1,152,383,000	盈餘轉增資 4,838 仟股	無	96.08.23 經授商字第 09601204680 號
97.08	10	200,000,000	2,000,000,000	121,608,332	1,216,083,320	盈餘轉增資 6,370 仟股	無	97.09.05 經授商字第 09701227130 號
99.09	12.4	200,000,000	2,000,000,000	122,404,582	1,224,045,820	員工認股權 憑證轉增資 796.25 仟股	無	99.09.1 6 經授商字第 09901210880 號
99.11	13	200,000,000	2,000,000,000	137,404,582	1,374,045,820	現金增資 15,000 仟股	無	99.11.08 經授商字第 09901249040 號
99.12	12	200,000,000	2,000,000,000	137,409,582	1,374,095,820	員工認股權 憑證轉增資 5 仟股	無	99.12.21 經授商字第 09901280150 號
107.11	10	200,000,000	2,000,000,000	123,668,624	1,236,686,240	現金減資 13,741 仟股	無	107.10.08 經授商字第 10701125510 號
108.09	10	200,000,000	2,000,000,000	117,548,624	1,175,486,240	庫藏股減資 6,120 仟股	無	108.09.25 經授商字第 10801140760 號
112.07	10	200,000,000	2,000,000,000	111,678,624	1,116,786,240	庫藏股減資 5,870 仟股	無	112.07.06 經授商字第 11230109950 號

115年3月23日

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份 (興櫃)	未發行股份	合計	
普通股	111,678,624 股	88,321,376 股	200,000,000 股	無

若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露相關資訊:無此情形。

2、主要股東名單：

115年3月23日 單位:仟股

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比例
欣興電子股份有限公司 代表人:簡山傑		27,197	24.35%
欣揚投資股份有限公司 代表人:蘭庭		7,782	6.97%
陳淑珍		2,771	2.48%
鄭德燦		2,457	2.20%
余明洋		2,224	1.99%
陳福龍		1,608	1.44%
永豐餘建設開發股份有限公司 代表人:駱秉正		1,542	1.38%
志聖工業股份有限公司 代表人:梁茂生		910	0.81%
曾子章		893	0.80%
謝立帆		885	0.79%

3、公司股利政策及執行狀況：

(1)本公司現行章程之股利政策：

第十九條之一:本公司年度如有獲利，應提撥百分之八至百分之二十為員工酬勞，並得提撥不高於百分之一為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以現金或股票方式發放之，發給之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金方式為之。

員工酬勞及董事酬勞之比例由董事會依法決議行之，並報告股東會。

第廿條：本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之。

(一)提繳稅捐。

(二)彌補累積虧損。

(三)提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額

時，不在此限。

(四)依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。

(五)其餘並得加計以前年度之未分派盈餘由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案，提請股東會決議之。

本公司分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規畫等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。盱衡本公司屬高科技之電子產業，未來不乏擴充計劃及資金之需求，每年發放之現金股利最少為股利合計數之百分之十。

(2)本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司 114 年度係屬虧損，業經第十屆第四次董事會決議通過不發放股利，俟提請 115 年股東常會決議通過。

(3)預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

4、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

5、員工、董事及監察人酬勞：

(1)公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

依本公司公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐及彌補以往年度虧損，次提10%為法定盈餘公積並依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積，如尚有餘額，再就其餘額提撥百分之八至百分之二十為員工酬勞，本項員工酬勞數額之百分之二十二應為基層員工分配酬勞，並得提撥不高於百分之一為董事酬勞。

前項員工酬勞及基層員工分配酬勞得以現金或股票方式發放之，發給之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金方式為之。

前二項應由董事會特別決議行之，並報告股東會。

(2)本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

因本公司114年度係屬虧損，本期並無員工紅利及董事酬勞金額之估列等情事，故不適用。

(3)董事會通過分派酬勞情形：

(a)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無此情形。

(b)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情形。

(4)前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無此情形。

6、公司買回本公司股份情形：

(1)已執行完畢者：

買回期次	105 年度第一次	108 年度第一次
董事會決議日期	105/05/10	108/12/17
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	105/5/12~105/7/11	108/12/19~109/2/18
買回區間價格	每股新台幣 3.5~7.65 元	每股新台幣 3.19~6.83 元
已買回股份種類及數量	普通股 6,800,000 股	普通股 5,870,000 股
已買回股份金額	新台幣 40,053,300 元	新台幣 29,883,283 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	6,800,000 股	5,870,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股
累積持有本公司股份 占公司已發行股份數之比率(%)	0%	0%

(2)尚在執行中者：無。

二、公司債辦理情形

無。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形

A. 員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

B. 限制員工權利新股辦理情形：

(一)凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

無。

七、資金運用計劃執行情形：

無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 本公司所營業務之主要內容：

- ① 合成樹脂製造業。
- ② 黏性膠帶製造業。
- ③ 電子零組件製造業。
- ④ 其他化學製品零售業。(高純度酸鹼溶劑、顯影劑、光阻劑、剝離劑)
- ⑤ 電子材料零售業。
- ⑥ 製造輸出業。
- ⑦ 其他化學材料製造業。(高純度酸鹼溶劑、顯影劑、光阻劑、剝離劑、線漆)
- ⑧ 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 主要產品營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品	114年度	
	營業收入	營業比重(%)
銅箔基板	129,897	30%
代工收入	136,261	32%
玻璃纖維布黏合片	56,781	13%
軟板	53,454	12%
精密化學	45,652	11%
複合材	9,124	2%
其他	933	0%
合計	432,102	100%

3. 公司目前主要銷售產品項目：

- ① 軟硬結合板用 Low CTE Non-flow PP 低熱膨脹不流動粘結片、玻璃纖維布黏合片製造、加工及銷售
- ② 銅箔基板製造、加工及銷售
- ③ 3C NB 外殼, 底座等熱塑鋁鋁/鋁鎂合金板材壓合板
- ④ 晶圓拋光用 Kevlar 纖維板
- ⑤ 多種印刷電路板壓合代工
- ⑥ 乾膜型防焊/兩液型顯像顯像防焊油墨/抗電鍍油墨
- ⑦ 晶片電阻保護油墨
- ⑧ 玻璃基板應用材料
- ⑨ 觸控面板材料
- ⑩ 軟板及軟硬複合板材料

4. 新產品之開發計劃：

- ① 觸控面板耐高溫可剝膠之開發
- ② 玻璃基板材料

- ③低掉粉不流膠 PP
- ④符合歐盟新禁用物質規定之乾膜防焊
- ⑤5G RCC

(二) 產業概況：

1. 產業現況與發展

(1) 印刷電路板市場趨勢

印刷電路板 (PCB) 是電子產品之母，台灣擁有全球最大 PCB 產業鏈，過去以兩岸生產運籌為優勢；美中貿易戰開打以來，供應鏈採取「中國+1」策略，滿足客戶分散風險的要求。2025 年全球 PCB 產值以標準多層硬板(38%-40%)、IC 載板(18%-20%)及 HDI 板(16%-18%) 為主要類別，反映產業重心從消費電子轉向 AI 高階應用。Prismark 數據顯示高多層板(18層以上)成長最快(41.7%)，而通訊(30%)與電腦(26%)為兩大終端應用市場。2026 年印刷電路板 (PCB) 市場正受 AI 運算、6G 基礎建設與電動車電子化帶動，進入「結構性成長」的黃金期。

根據台灣電路板協會 (TPCA) 引述 Prismark 的數據，指出，2025 年至 2026 年全球印刷電路板 (PCB) 市場進入強勁成長期，主要受 AI 伺服器與衛星通訊雙引擎驅動。全球 PCB 產值預計在 2025 年增長 6.8%，預計 2026 年全球 PCB 產值將達到 1,031 億美元的歷史新高，台灣 PCB 產業鏈產值在 AI 邊緣裝置發展高整合加持下，2026 年預估將持續突破 1.3 兆新台幣。

(2) 全球銅箔基板市場趨勢

全球銅箔基板 (CCL) 市場正處於由 AI 基礎建設帶動的「超級週期」。隨著 AI 伺服器與高效能運算需求爆發，CCL 市場正經歷從材料規格到產值規模的全面跳升。根據高盛與 Prismark 的最新報告全球 AI 伺服器 PCB 市場規模預計將從 2024 年的 31 億美元，噴發至 2027 年的 271 億美元，其中 2026 年與 2027 年的年增率分別高達 114% 與 117%。位於產業鏈上游、扮演關鍵材料角色的 CCL，成長動能更為猛烈。依據高盛預測，全球 AI 伺服器 CCL 市場將從 2024 年的 15 億美元，激增至 2027 年的 187 億美元。值得注意的是，CCL 在 AI 基礎建設持續推進下，技術升級與規模放量的雙重效應，產業將迎來多年難得一見的景氣循環，預估在 2026 年與 2027 年增率分別為 142% 與 222% 的爆發式年增長。

(3) 面板產業市場趨勢

隨著中國面板廠佔據全球約 70% 產能，產業邏輯已從規模競爭轉向利潤管理。2025 年面板市場受美國關稅政策不確定性與消費市場疲軟影響需求增速放緩顯示面板面積需求僅增長約 2%。進入 2026 年全球面板產業正處於「技術轉型」與「規格升級」的核心成長期。根據 Omdia 與 TrendForce 的最新數據，市場正擺脫傳統液晶面板 (LCD) 的供過於求壓力，轉向由 AI PC、高階車用及 OLED 滲透率提升帶動的價值增長。市場預計 2026 年全球顯示面板市場產值預計約為 1,405 億美元。

(4) 玻璃基板產業市場趨勢

在 AI 基礎建設高速擴張下，Gartner 指出，至 2029 年全球 AI 基礎設施 IT 支出將達 2.3 兆美元，2025 至 2029 年均成長率高達 23.6%，成長動能主要來自超大規模雲端服務商。而隨著大型語言模型跨越數兆參數門檻，2026 年正處於 AI 發展的關鍵轉折點，硬體需求從「模型訓練」擴張至大規模推理與 Physical AI 領域。因此高盛預估，NVIDIA Blackwell 與 Rubin 架構將使 CoWoS 產能長期維持緊俏，其瓶頸集中於超大尺寸晶片所帶來的翹曲與熱應力挑戰。矽中介層面積持續放大，不僅導致良率下滑、成本攀升，也迫使產業加速轉向 CoWoS-R、CoWoS-L 等新架構，同時推升 ABF 載板需求，形成結構性供給壓力。

在此背景下，玻璃基板被視為突破大尺寸封裝瓶頸的關鍵材料。相較有機基板，玻璃具備高剛性、低翹曲、低介電耗損與尺寸穩定等優勢，被視為解決超大尺寸封裝限制的重要技術方向。近年SKC、三星與英特爾已陸續布局量產，台灣廠商憑藉載板製造與封裝測試的垂直整合優勢，有利站上AI與高效能運算封裝供應鏈中的關鍵戰略位置。

2. 產業上、中、下游之關聯性

(1) 銅箔基板

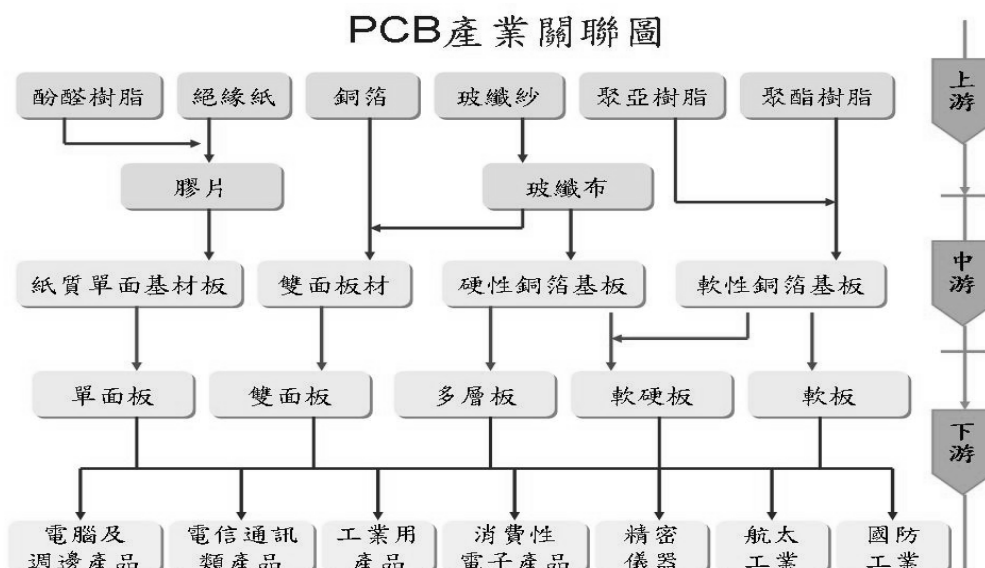
印刷電路板(PCB)是電子產品的電源與訊號傳輸的基材，最主要功能是提供電氣連接以及元件承載，是電子零組件安裝及互連主要支撐體。可廣泛應用於資訊、通訊、光電、汽車、消費性電子或家電……等產品上(PCB產業結構如下表)。在電子產品對於面積、體積、功能…等特性要求之下，也引領著PCB產品與技術一直在演進，從新興的電子產品當中，我們可以嗅出PCB產業在未來可能的發展趨勢，可作為PCB產業在未來規劃發展之參考資訊。

原材料	酚醛樹脂、環氧樹脂、PI、玻纖紗、玻纖布、銅箔
銅箔基板	紙質基板、複合基板、玻纖環氧基板、軟質基板、樹脂基
製程化學品	蝕刻液、電鍍化學品、綠漆、乾膜、PCB 生產設備、製程
電路板	單面板、雙面板、多層板、軟板、軟硬板、IC 載板
應用產品	資訊及週邊產品、通訊、光電、消費性電子、民生家電、工業產品、精密儀器、汽車、航太軍用

資料來源：工研院 IEK(2008/03)

銅箔、樹脂、玻纖布是印刷電路板產品最上游的原料，藉由這些原料可生產出銅箔基板及玻璃纖維膠片，而印刷電路板就是由銅箔、銅箔基板及玻璃纖維膠片所生產出來的。我國之印刷電路板產業體系相當完備，從銅箔、樹脂、玻纖布到印刷電路板皆有廠商生產，自給度相當高。本公司主要產品為玻璃纖維布黏合片、銅箔基板、多層基板壓合代工及化學品生產等。其中玻璃纖維布黏合片與銅箔基板係屬印刷電路板之關鍵原料，多層基板壓合代工則屬印刷電路板前段製程作業，而化學品則主要供應印刷電路板業者所需的防焊油墨（即綠漆）。本公司的玻璃纖維布黏合片及銅箔基板除供對外銷售給一般印刷電路板廠商使用外，前者並提供內部生產銅箔基板原料使用，後者提供內部多層基板壓合代工原料。

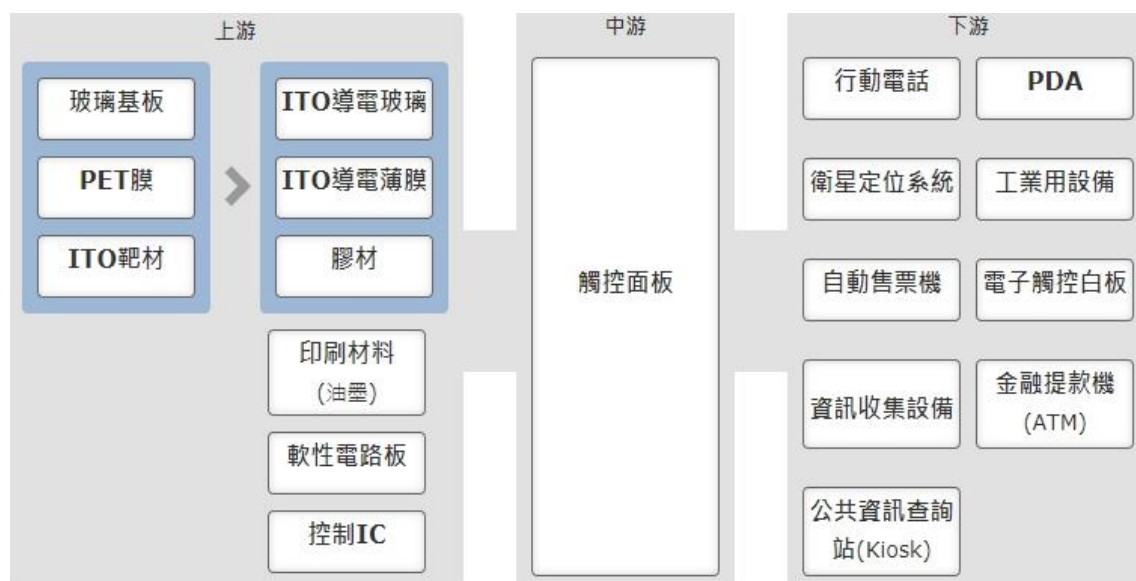
印刷電路板上下游產業涵蓋範圍甚廣，茲將其產業上、中、下游關聯圖列示如下：



資料來源：工研院材料所

(2)精密化學品

觸控面板技術相當多元，依感應方式不同，可區分為電阻式、投射式電容、表面式電容、表面聲波式、紅外線式及光學式等，隨著 Apple 行動終端採用電容式觸控後，投射式電容觸控技術已廣泛被應用在智慧型行動電話及平板電腦。其相關上下游產業資料如下：



3. 產品之各種發展趨勢

2026年電子產業正處於從「硬體銷售」轉向「AI 加值」與「跨域整合」的劇烈變革期。在AI算力落地終端與衛星網路普及的推動下，產業呈現以下四大核心趨勢：

1. 「AI Everywhere」：AI 不再只是雲端服務，而是直接整合進硬體（Edge AI），這強迫下游電子產品必須進行規格「軍備競賽」。
2. 衛星通訊與行動通訊的「合流」：2026 年是 **6G 預研** 與 **NTN(非地面網路)** 商用化的重要里程碑。
3. 半導體封裝的技術轉型：當晶圓微縮（3nm 以下）成本過高，產業重心轉向「封

裝」FOPLP 與 Chiplet。

4. 車用電子：從「電動化」轉向「智能化」：雖然電動車增速放緩，但車內電子零件價值仍持續攀升。

4. 競爭情形

A、玻璃纖維膠片、銅箔基板

本公司目前所生產之銅箔基板係屬於玻璃纖環氧樹脂基板，而市場上約有13家製造商生產此類產品供下游印刷電路板使用，目前上市公司中有生產者為南亞、聯茂、宏泰電工、台光電子及慶輝電子KY，上櫃公司則為台耀，興櫃公司則有本公司，另未上市公司中德聯、寶利德、Isola及松下電工等專業基板製造商。

B、多層壓合基板

近年來國內PCB產業外移代工代工需求減少，本公司進行人力精簡與轉型並終止從基板投料到內層至壓合一貫作業之Masslan代工業務。專注純代工領域，鞏固並擴大特定客戶代工業務，滿足客戶需求。

C、觸控面板化學材料

本公司目前所生產之觸控面板化學材料係屬於觸控面板/觸摸屏之絕緣膠、可剝膠、抗酸油墨、耐高溫油墨、邊框油墨等。本公司具研發暨客製化能力，與觸控產業主要供應鍊之大廠建立合作關係並透過客戶取得國外終端客戶認證以提高知名度暨指定用料之機會。目前主要材料供應來源有日系品牌及國內廠商如洵倫、長興化工、綠固、聯致、愛笛克…等。

D、乾膜型防焊材料

本公司目前開發乾膜型防焊主要應用於PCB載板及被動元件應用。本公司具研發暨客製化能力，透過客戶取得國外終端客戶認證以提高知名度暨指定用料之機會。目前主要材料供應來源有日系品牌及國內廠商如長興化工及大陸多家品牌競爭。

E、玻璃基板應用材料

本公司所開發之PSR-600A FT-1材料，為運用於玻璃基板製程所開發，其為熱固化、高感度、高解析、及低膜厚需求、全透明、高透光(視)率。能因應不同的客戶需求做調整。目前主要競爭對手均為日系品牌。

F、軟板軟硬結合板

目前主要以Non flowpp及純膠為主力產品,主要在大陸地區銷售。近年受日系及國產品低價銷售競爭更虛設法降低生產及營運成本以提升競爭力。

G、防焊油墨

目前台灣防焊油墨市場主要供應商有：太陽油墨、聯致、南亞與尚洪…等，其中以日本之太陽油墨公司為主要領導廠商。隨著中國供應商的崛起，佐以較低生產成本之競爭優勢，已逐漸侵蝕台、日系廠商之市佔率，台灣之油墨製造廠商已無太大之成長空間。

。

(三) 技術及研發概況：

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	115 年 3 月 25 日止(註)
研發費用	14,819	1,927
營業收入淨額	432,102	52,381
研發費用所占比例(%)	3.43	3.68

註：截止至 115 年 3 月 25 日止係本公司自結數。

2. 最近年度開發成功之技術或產品

年度	研發成果
105~106 年 度	1. Low dn/dt 光學鏡片樹脂製造及其應用。 2. 常溫儲存型光成像介電材料研發。
109 年	Mini-LED 用高反射率白色防焊乾膜及油墨
112 年	BT(Bismaleimide Triazine)樹脂應用軟硬複合材料
114 年	1. 玻璃基板用曝光顯影型材料 2. 觸控面板可撥膠之開發 3. 5G-RCC 材料
114 年	1. 內層純膠 2. 低掉粉不流膠 PP 3. 5G 高頻純膠 4. 玻璃基板熱固型乾膜 5. 5G 高頻乾膜型防焊油墨 6. 兩液型一段式後烤塞孔油墨 7. 被動元件用高可靠性乾膜防焊

(四) 長、短期業務發展計劃：

本公司為電子材料之專業供應商，主要產品為各式銅箔基板、IC 載板基材、光阻產品及觸控面板/觸摸屏及 Mini LED 產業之相關材料。為因應市場上產業發展趨勢及國內外市場競爭，期望藉由長短期發展計畫之實踐以調整公司體質，提昇整體競爭力。

1. 短期發展計畫

- ① 確保特定客戶營業額，以提高稼動率、降低單位成本，增進公司整體經營效益。
- ② 強化行銷開拓新客戶，推廣玻璃基板之化學品材料與 5G/6G 高頻通訊材料。
- ③ 建立策略性安全庫存與多元供應體系，以因應地緣政治可能導致的原料短缺風險。
- ④ 深化客戶合作，辨識其從研發到量產的製程缺口，評估投入高價值的代工服務。

2. 長期發展計畫

- ① 掌握市場脈動與未來發展趨勢，秉持利基導向，以「高階技術領先、精實營運」為策略主軸，維持技術領先地位。
- ② 採取「技術前導型行銷」，深化與客戶的協同研發、開發關係。

- ③透過精實生產管理確保交期精準度與資本使用效率，創造經濟價值，達成永續經營之目標。
- ④長期培養國際行銷專業人才，充分掌握國際市場資訊，調整產品策略提高市占率，以達到國際化的目標。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析：

1、主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

項目		年度	113 年度	114 年度
		內銷		260,829
外銷	亞洲	114,797	106,787	
	小計	114,797	106,787	
合計		375,626	432,102	

2、市場占有率

本公司目前所生產之銅箔基板係屬於玻璃纖環氧樹脂基板，在台灣市場上約有 13 家製造商生產此類產品供下游印刷電路板使用。本公司產能規模小，其市佔率不足 1%。

3、市場未來之供需狀況與成長性

印刷電路基板對於電子設備的製造至關重要，有助於電子元件的互連和正常運作。PCB 板廠受惠於伺服器、AI、HPC 等需求帶動，板材追隨 CPU、GPU 升級。該市場的推動因素包括對更小、更強大的電子設備的需求不斷成長、對高效互連解決方案的需求不斷成長以及技術的持續進步。展望未來，因 AI 應用的爆發、高效能運算，推動高速和更低損耗之高階材料需求加速上升，材料端朝向高頻、高速傳輸的 CCL 材料發展及相關產業鏈業績將顯著增長。

4、競爭利基

①市場面：

- 產品定位明確，鎖定高階及環保材料應用之領域，朝 AI、通訊、NB、觸控、光電產業、休閒運動及遊戲機等市場之利基產品。
- 持續推展乾膜防焊、晶片電阻保護油墨、玻璃基板應用材料純膠與可撥膠等產品，取得國際系統大廠認證，在產品推展上具備一定優勢。
- 本公司已建構兩岸三地的銷售據點，將對於行銷通路及市佔率有正面助益。後續將於東南亞泰國進行佈局規劃。

②產品面：

- 本公司提供產品多元化服務，除供應多項關鍵材料外，並提供壓合、裁切代工服務之能力。
- 本公司產品符合國際化需求，供應高精密度之高階基板及無鹵無鉛製程環保

基板及相對應材料。

- C. 本公司具備專業材料開發人才、彈性調整產品配方與產品組合，並提升製程能力以成功擴展軟板及軟硬複合板材料, 觸控面板及被動元件材料之市場。
- D. 積極拓展乾膜防焊之客戶認證與導入量產。
- E. 積極推展玻璃基板、輕質板等材料研發、認證以及相關客戶開發。

③技術面：

- A. 所供應產品為利基導向並符合世代潮流且具多元性，顯見在關鍵製程及高階材料具備創新及研發能力。
- B. 本公司對高階產品材料研發具備一定專業能力，以滿足客戶少量多樣及特定生產技術之需求，並極力配合客戶要求之交期，且積極開拓市場。
- C. 開發玻璃基板與銅箔之間的接著層，參與客戶端其功用在於增加銅箔與玻璃基板的附著力，也是玻璃基板上相關線路的生成關鍵的技術

④管理面

- A. 扁平化組織及精英政策，進行跨事業部門壓合製程合作使公司在營運上具有高效率及專業化。
- B. 隨著國際行銷人才之建置，將可對資源整合及產能運用作更有彈性之擘畫，以提高公司整體效益。

5、發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①有利因素

- A. AI 產業的爆發性成長正全面重塑印刷電路板與銅箔基板產業，將其從傳統的週期性產業轉變為高技術門檻的成長型產業。
- B. 玻璃基板應用材料精準擊中玻璃基板「結合力難度高」與「材料應力大」的兩大痛點。未來應著重於低介電常數（Low Dk/Df）的實測數據驗證，以及與 TGV（玻璃通孔）技術的相容性，以鞏固在先進封裝市場的領導地位。
- C. 與上下游廠商維持良好關係並互動密切，對國際原物料之供應狀況掌握良好，對於下世代新產品之需求亦較同業提早掌握相關資訊並預先積極投入準備及研發。
- D. 產品多元化符合市場需求並積極開拓市場，滿足客戶需求與服務。

②不利因素與因應措施

- A. 玻璃基板仍處於從研發轉向試產的階段（預計 2026-2027 年商用化）。目前仍面臨良率挑戰及搬運易碎性等問題。
- B. 公司產能規模相較同業為小，產品售價調正自主性低，在面對上游主要原物料售價波動，相對於產品成本轉嫁的機率和速度，將直接影響公司獲利表現。

因應措施：

- A. 隨著 AI 需求爆發，市場轉向 M9 規格與玻璃核心基板等新材料，聯致需加速技術轉型以維持競爭力。。
- B. 分散原物料供貨來源以取得合理成本之原物料與供應量。
- C. 搭配海外子公司銷售團隊、與當地經銷商建立良好合作夥伴關係，拓展銷售網路及強化海外市場。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

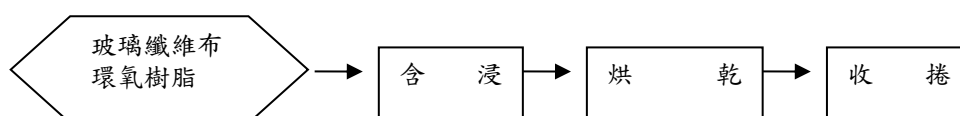
1. 主要產品之重要用途：

主要產品	重要用途
玻璃纖維布黏合片	在基板中擔任絕緣及支撐補強角色。
銅箔基板	為印刷電路板關鍵性材料；印刷電路板主要是由內層銅箔基板加上外層銅箔層層疊合架構，並經顯影、刻蝕、壓合、鑽孔、電鍍等程序，在板上呈現各零組件間的電路，以此構成的線路板即為印刷電路板，其須具備良好耐熱性質、耐化性、電氣性質及其他特殊需求之功能。
精化(化學品)	<p>印刷電路板之光阻及防焊油墨：</p> <p>前者係印刷電路板之內層用蝕刻光阻劑，用於內層影像轉移製程及線路製作；後者即所謂綠漆，提供印刷電路板一層永久保護層，使裸露外層的銅線路獲得局部保護及絕緣，以區分組裝區與非組裝區，同時達到阻絕焊料侵蝕、保護銅面之目的。</p>
	<p>觸控面板/觸摸屏之保護膠、絕緣膠：</p> <p>「保護膠」應用於保護觸控面板之關鍵區。提供面板關鍵區於生產、轉運、蝕刻等流程不受侵蝕、碰撞等等防護要求，而能保持產品之良好品質；或提供產品於一般印刷狀況下，防止污染之基本保護需求。且於生產關鍵流程結束後，保護膠可輕易剝離，達到對工作物件提供防護且無衍生污染之要求。</p> <p>「絕緣膠」，應用於網印塗佈製程，所塗佈之液態UV 感光絕緣膠膜面平坦性良好、無針孔，可提供良好的絕緣能力。</p> <p>乾膜防焊：</p> <p>「乾膜防焊」油墨為預先成型之感光型樹脂薄膜，主要應用於印刷電路板製程中之線路保護與絕緣層形成。其材料透過真空貼附方式覆蓋於電路板表面，經曝光、顯影及後固化後，在銅線路上形成精準且均勻的防焊保護層，具備厚度均勻性佳、解析度高、耐熱與耐化學性優異及製程穩定度高等優點。</p>
	<p>純膠：</p> <p>具備良好的流動填充能力、優異的接著強度、穩定的電氣絕緣特性及製程彈性高等優點，能因應不同產品結構設計進行厚度與流動性調整，因此廣泛應用於高密度化與輕薄化電子產品之電路板製造中。</p>

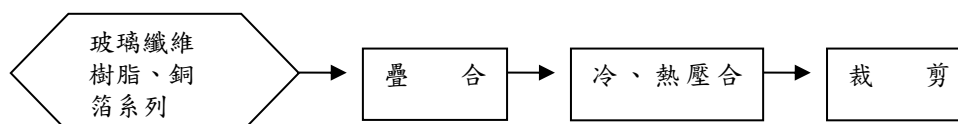
主要產品	重要用途
	<p>被動元件材料：</p> <p>保護油墨（Overcoat Ink）透過絲網印刷或者真空壓膜於電阻層上方，在經過熱固化後形成絕緣屏障，防止濕氣、灰塵、化學腐蝕及機械損傷滲入。它可確保電阻值穩定，避免外部因素如硫化或氧化影響性能。</p> <p>玻璃基板應用材料</p> <p>應用於玻璃基板與銅箔之間的接著層，主要在於增加銅箔與玻璃基板的附著力，也是玻璃基板上相關線路的生成關鍵的技術。可同時作為介電層與緩衝層。在先進封裝中，這能有效減少不同材料間（玻璃 vs. 矽晶圓）的熱膨脹係數（CTE）錯配，降低熱應力導致的玻璃破碎風險，提升產品良率。</p>
代工收入	提供印刷電路板前段製程之內層板壓合為多層板及裁切之代工服務。

2. 主要產品之產製過程：

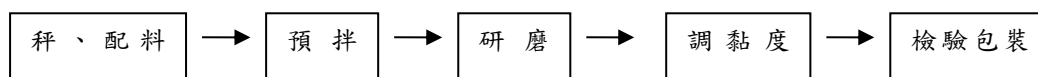
①玻璃纖維黏合片(PREPREG)製程：



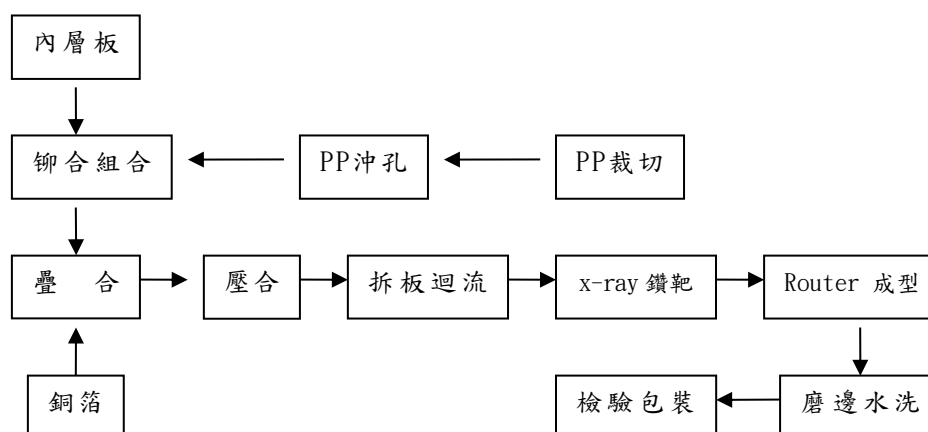
②銅箔基板製程：



③化學品製程：



④壓合代工製程：



(三)主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
化學品	南亞、阿托	良好
銅箔	李長榮、美杉	良好
玻布	南亞、台玻	良好

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因。但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之。

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	佔全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	A020	33,780	20	無	A020	44,868	24	無
2	B403	27,936	16	無	B403	34,726	18	無
3	—	—	—	—	—	—	—	—
—	其他	109,524	64	—	其他	110,789	58	—
	進貨淨額	171,240	100		進貨淨額	190,383	100	

說明：截至年報刊印日止未有最近一季經會計師查核之資料，故不揭露。

增減變動原因：本公司最近二年度占進貨總額百分之十以上之供應商維持不變。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	欣興電子(股)公司	175,751	47	對本公司採權益法評價之公司	欣興電子(股)公司	241,555	56	對本公司採權益法評價之公司
2	—	—	—	—	—	—	—	—
-	其他	199,875	53	—	其他	190,547	44	—
	銷貨淨額	375,626	100		銷貨淨額	432,102	100	

說明：截至年報刊印日止未有最近一季經會計師查核之資料，故不揭露。

增減變動原因：本公司最近二年度占銷貨總額百分之十以上之客戶，因 114 年對欣興電子(股)公司 PCB 產品代工大幅增加，致本公司對欣興電子(股)公司銷貨淨額增加。

三、從業員工資料

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數，平均服務年資，平均年齡及學歷分布比率：

年 度		113 年度	114 年度	115 年 3 月 25 日
員 工 人 數	直接員工	111	100	97
	間接員工	85	64	63
	合 計	196	164	160
平 均 年 歲		43.89	45.08	45.48
平 均 服 務 年 資		11.90	12.99	13.42
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	1.09	1.21	1.25
	碩 士	6.01	4.85	5.00
	大 專	38.8	36.97	37.50
	高 中	19.13	18.79	19.38
	高 中 以 下	34.97	38.18	36.87

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

五、勞資關係

1. 各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司重視每一位員工，除了提供良好工作環境外，並重視員工福利及提供學習成長空間。在員工福利措施方面，除依規定加入健、勞保外，並依法組織職工福利委員會及勞資會議，每三個月定期舉行會議，並每月提撥福利金，以推行各項福利政策，建立完善之福利制度。透過勞資會議之召開，開啟勞資雙方溝通管道，以促進勞資關係和諧並凝聚員工向心力。在員工教育訓練方面，本公司特別成立隸屬總經理之專責單位規劃員工教育訓練課程，透過訓練課程及參與講座提昇員工素質並改善企業體質。

- (1) 主要福利措施如下：

- ① 依績效考核結果分發年終獎金、績效獎金及分紅。
- ② 員工認股。
- ③ 員工提案獎金。
- ④ 三節禮金/禮品、生日禮金/禮品、結婚禮金、生育津貼、住院慰問金之補助。
- ⑤ 週休二日。
- ⑥ 享有特別休假、產假、流產假、陪产假、女性同仁生理假、育嬰假。
- ⑦ 享有勞、健、團保及眷屬團保並提供健康檢查。
- ⑧ 開放的溝通管道與晉升機會。

- (2) 員工進修、訓練及實施情形：

- ① 員工進修補助。
- ② 人資單位專責規劃員工教育訓練。

- (3) 退休制度：

本公司原依「勞動基準法」之規定，每月按給付薪資總額之一定比例提撥退休準備金，撥交由勞工退休準備金監督委員會專戶儲存及支用。後因「勞工退休金條例」自民國九十四年七月一日起施行，並採確定提撥制。實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不得低於員工每月薪資百分之六。本公司同時訂立有勞工退休辦法，凡受僱於本公司從事工作獲致工資者，均適用勞工退休辦法辦理。

- (4) 勞資間之協議：

本公司重視員工意見反應，定期召開勞資會議、設置「意見箱」..等，強化勞雇雙方意見溝通管道。資方借以宣導公司管理制度、福利政策，員工亦從而了解或表達對公司管理制度、主管領導、福利制度及工作環境之意見。故至目前勞資關係和諧，並無發生過重大之勞資糾紛。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

- (1) 因勞資糾紛所遭受之損失：108年度重勞訴字第14號，應給付新台幣415,309元及自108年9月26日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，並補提繳勞工退

休金 71,874 至勞工退休金專戶。惟該原告不服此一審判決，提起上訴。

前述民事訴訟案二審經高等法院民事 114 年 1 月 23 日判決，110 年度重勞上字第 32 號，應給付新台幣 295,430 元本息及第一審(除確定部分外)、第二審訴訟費用關於附帶上訴部分負擔五分之三；惟該原告不服此二審判決，於法定期間內再提起上訴；後於 114 年 3 月 10 日又撤回本件上訴。本案業於 114 年 3 月 11 日確定，本案給付金額含利息共計 44 萬餘元。

(2)未來可能發生之估計金額：無。

(3)因應措施：員工離職申請需本人親辦，如本人未前來辦理，則採曠職解雇處理。

六、資通安全管理

(一)敘述資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

1. 資通安全風險管理架構

資管課為資安專責單位，資管課主管負責統籌並制定資訊系統管理維護作業程序，改善資訊系統作業程序、安全管理等，宣導資訊安全訊息、加強同仁資安觀念。由稽核室每年就內部控制制度—電腦化資訊處理，進行資訊安全查核，評估公司資訊作業內部控制之有效性。

2. 資通安全政策

落實日常營運、確保資通訊服務、資訊安全訊息宣導、確保資通訊安全。

3. 具體管理方案

3.1 資料存取控制

3.1.1 人員初次使用系統、網路資料需權責主管核可。

3.1.2 人員系統登入及網路資料存取，需個人帳號密碼輸入。

3.2 檔案及設備安全

3.2.1 機房設備連接不斷電系統。

3.2.2 機房設置防範災害設施。

3.2.3 檔案及程式等相關定期備份。

3.2.4 防毒軟體自動掃描。

3.3 系統復原及測試程序

3.3.1 訂定系統復原計畫。

3.3.2 定期檢討及演練。

3.4 資通安全檢查

3.4.1 防火牆定期檢測。

3.4.2 防毒軟體定期檢測。

4. 投入資通安全管理之資源

不定期以時事作為資通安全範例宣導，適當編列預算強化資通安全管理及防護。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
廠租	欣興電子股份有限公司	106.07.01~ 115.06.30	廠房租金	無
授信契約	中國信託商業銀行	114.09.30~ 116.09.30	中期抵押貸款	1. 最後動撥日：首次動撥後起算一年。 2. 寬限期一年，寬限期後起算每季平均還本。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	增 減 變 動	
				金 額	%
流動資產		901,626	908,853	7,227	0.80
不動產、廠房及設備		149,865	151,422	1,557	1.04
無形資產		2,188	1,624	(564)	(25.78)
其他資產		211,298	188,462	(22,836)	(10.81)
資產總額		1,264,977	1,250,361	(14,616)	(1.16)
流動負債		132,128	135,276	3,148	2.38
非流動負債		5,589	3,400	(2,189)	(39.17)
負債總額		137,717	138,676	959	0.70
歸屬於母公司業主之權益		1,077,777	1,062,613	(15,164)	(1.41)
股本		1,116,786	1,116,786	-	0.00
資本公積		114,271	114,271	-	0.00
待彌補虧損		(203,452)	(239,717)	(36,265)	17.82
其他權益		50,172	71,273	21,101	42.06
非控制權益		49,483	49,072	(411)	(0.83)
權益總額		1,127,260	1,111,685	(15,575)	(1.38)
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目之主要原因及其影響及未來因應計畫：					
<ol style="list-style-type: none"> 1. 無形資產減少主要為逐年攤銷費用所致。 2. 非流動負債減少主要為 114 年租賃修改使租賃負債非流動減少所致。 3. 其他權益增加主要為 114 年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益增加所致。 					

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113 年 度	114 年 度	增 減 變 動	
		金 額	金 額	金 額	%
營業收入		375,626	432,102	56,476	15
營業毛利		15,077	30,780	15,703	104
營業損益		-79,320	-54,368	24,952	31
營業外收入及支出		193,646	17,191	-176,455	-91
稅前淨利		114,326	-37,177	-151,503	-133
本期淨利(損)		64,411	-39,395	-103,806	-161
本期其他綜合損益(稅後淨額)		-10,193	23,820	34,013	334
本期綜合損益總額		54,218	-15,575	-69,793	-129
淨利歸屬於母公司業主		55,108	-39,199	-94,307	-171
淨利歸屬於非控制權益		9,303	-196	-9,499	-102
綜合損益總額歸屬於母公司業主		44,117	-15,164	-59,281	-134
綜合損益總額歸屬於非控制權益		10,101	-411	-10,512	-104
最近二年度增減比例變動分析說明：					
1. 營業毛利增加，主係壓合代工訂單量增加，及軟板銷量上升，銷貨收入增加約15%，使稼動不足比率降低。					
2. 營業外收入及支出減少，主係為113年度處分投資性不動產利益164,840仟元所致。					
3. 本期其他綜合損益(稅後淨額)增加，主係為114年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益增加所致。					

(二)預期未來一年銷售數量與其依據

本公司持續著重在不流膠 PP、5G 高頻油墨、乾膜防焊、純膠、OTP 可撥膠為營運的主軸及玻璃基板材料等產品。未來一年銷售計畫係依據合約、最近銷售狀況及市場變化與客戶營運展望之情況預估訂定。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

電路板產業為分散地緣政治風險與擴展新市場，陸續於東南亞地區投資設廠，其產能亦陸續開出。在此波東南亞投資潮下，影響其在台發展的資源，對本公司壓合代工業務影響顯著。本公司代工部門進行人力精簡並與CCL進行產能整合以鞏固即有客戶，後續將於東南亞泰國進行佈局規劃等因應措施。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 ①	全年來自營業活動淨現金流量②	全年現金流入量③	現金剩餘(不足)數額①+②+③	現金不足之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
658,697	-37,969	36,835	657,563	--	--
本年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：本公司 114 年度因營業虧損，致營業活動產生淨現金流出 37,969 仟元。					
(2)投資活動：本公司 114 年度主係因出售金融資產，產生淨現金流入 27,574 仟元。					
(3)融資活動：本公司 114 年度主係因向銀行借款，致融資活動產生淨現金流入 13,334 仟元。					
(4)匯率影響數造成現金流出 4,073 仟元					

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額①	預計全年來自營業活動淨現金流量②	預計全年現金流出量③	現金剩餘(不足)數額①+②-③	預計現金不足之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
657,563	-5,174	24,732	627,657	--	--
未來一年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：未來一年預計營業活動將產生淨現金流出。					
(2)投資活動及融資活動：主係取得設備，利息支出及租賃本金償還現金流出。					
(3)現金不足額之補救措施及流動性分析：無。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無

(二)重大資本支出之預計可能產生效能：無

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

單位：新台幣仟元

項目	說明	114年度 獲利或虧損金額	政策	虧損之 主要原因	改善 計畫	未來一年 投資計畫
Willy Holdings Ltd.		(1,214)	海外投資之控股公司，持股 AMC Holding Ltd 92.91% 之股份。	虧損主係來自投資子公司 AMC Holding。	無	無
AMC Holding Ltd.		(1,268)	海外投資之控股公司，100% 持股蘇州聯致科技有限公司。	虧損主係來自投資子公司蘇州聯致。	無	無
蘇州聯致科技有限公司		(4,258)	預計 115 年進行清算	虧損主係來自繳納所得稅金。	無	無
AMC Materials Ltd.		(587)	海外投資之控股，100% 持股東莞市聯致電子科技有限公司。	虧損主係來自投資子公司東莞聯致。	無	無
東莞市聯致電子科技有限公司		(1,110)	主要代銷台灣電子材料等。	虧損主係來自 114 營業費用增加所致。	無	無
鈺順材料股份有限公司		(182)	主要銷售化學製品等零售業。	106 年 1 月成立，公司仍在研發階段，營收少	無	無

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司平日與銀行保持密切聯絡並維持良好關係，在與銀行往來借款時均議定合理的利率價格及條件，對公司之營運或舉債成本均有助益。在匯率方面本公司外匯下降，匯率波動風險有限，現有外幣資金配置以定存為主，並做適度分配，以降低其風險。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

(1) 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司主要專注於本業之耕耘發展，重視本業技術之研發及業務行銷之拓展，且本公司向以穩健經營為原則，財務健全。最近年度及截至公開說明書刊印日止並未從事高風險、高槓桿投資之行為。

(2) 從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等辦法作為相關作業之依據，並經股東會決議通過據以執行。

A. 從事資金貸與他人方面：截至年報刊印日止，無資金貸與他人之情形。

B. 從事背書保證方面：截至年報刊印日止，無背書保證情形。

C. 從事衍生性商品交易方面：本公司 114 年度及 115 年截至年報刊印日止並未從事任何衍生性商品交易。未來本公司從事任何以上交易活動均按本公司所定相關作業辦法執行，故風險應在掌控中。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司相當重視研究發展工作，每年均投注一定金額於研發計畫中，研發部門組織亦逐步擴編。未來研發方向除以既有產品擴充、創新製程技術、控制品質穩定度與降低成本為主要方向外，並利用本公司核心製程技術開發更多元產品應用，以契合未來對於高效能及各式規格期待之趨勢不斷進行研究發展。茲就未來研發計畫與投入研發費用整理如下：

單位：新台幣仟元

研發計劃	預計投入研發費用	預期對公司產生之效益
玻璃基板曝光顯影型材料之優化	12,292	①提升增加產品附加價值 ②配合客戶開發新材料 ③開發新市場與客戶群
玻璃基板熱固型乾膜之優化		
被動元件用導熱絕緣油墨開發		
被動元件用高 Tg、低熱膨脹係數熱硬化型乾膜		
超低熱膨脹係數、高 Tg 銅箔基板材料		
UV 固化可剝膠開發		
5G 高頻乾膜型防焊油墨之優化		

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本集團日常營運均遵循國內外相關法令辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法令變動情形，以隨時調整營運策略，故預期本集團未來應不致受國內外重要政策及法律變動而有重大不利之影響。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

電子產業，包括 PCB 製造業，越來越注重環境的永續性。RoHS（有害物質限制）和 WEEE（廢棄電氣和電子設備）等與有害物質相關的法規正在迫使 PCB 材料和製造流程變得更加環保。本公司隸屬印刷電路板產業，具有生產無鉛無鹵產品之技術能力。更致力於新產品研發、製程改善及技術提升，使污染產生量最少化，環保基材產品訂單獲得客戶認證，故科技改變將創造需求，對本公司有正面助益。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，企業形象始終良好，自成立以來均專注於本業經營，持續加強公司治理、重視員工教育訓練、引進優秀人才，並採行專業經理人經營發展模式，並依證券交易法規定選任獨立董事、設立薪酬委員會及審計委員會，故應能有效處理企業危機。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有進行併購之計畫，惟將來若有進行併購計畫時，必秉持審慎評估態度，考量合併是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障股東之權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至年報刊印日止，尚無擴充廠房之計畫，未來視景氣狀況評估是否擴展大陸市場。其擴充產能之資金來源來自於資本募集及融資活動。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

- (1) 進貨集中：本公司產品之主要原料為銅箔、玻纖布、碳纖布、化學品、膠類與樹脂等，原料採購策略係綜合考量供應商品質、價格、交期及國際間未來原料是否短缺等因素選擇適合供應商及彈性化調整備品期，且本公司對於主要原料均維持兩家以上之供應商，並無進貨集中風險存在。
- (2) 銷貨集中：就個別銷貨對象而言，本公司 114 年度對最大銷貨客戶之銷售金額佔營收比重分別為 56%，其餘銷貨客戶均未達營收比重 10% 以上。本公司除持續尋找其他合作客戶並維持良好關係外，未來新產能開出將擴大服務範圍，並同時致力於新產品之開發，有助於拓展本公司銷貨客戶，消彌銷貨集中風險。

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，董事或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司經營團隊均致力於公司之永續發展，最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

(十二) 董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司訴訟或非訟事件：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，董事或持股超過百分之十之大股東，並無訴訟或非訟之情事。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

資安風險評估分析：

在這資安威脅環伺的情狀之下，電子製造業在發展資訊科技的同時，應該從下列重要事項行為進行以下資安治理強化措施：

- (1) 蒐整政府機關 12 月資安聯防情資共 6 萬 1,580 件，分析可辨識之威脅種類，第 1 名為資訊蒐集類(45%)，主要是透過掃描、探測及社交工程等攻擊手法取得資訊；其次為入侵嘗試類(21%)，大多是嘗試入侵未經授權主機；以及入侵攻擊類(18%)。統計近 1 年情資數量分布及資安事件通報統計，詳圖 1 及圖 2。

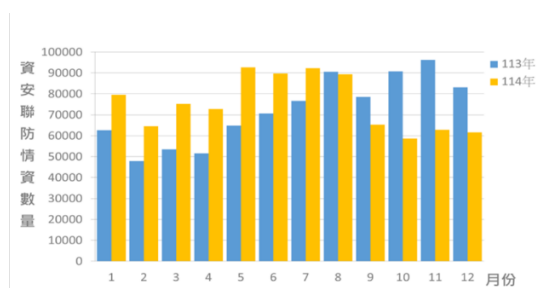


圖 1 資安聯防監控資安監控情資統計

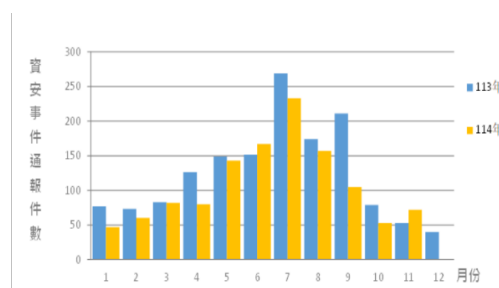


圖 2 資安事件通報統計

- (2) 政府機關發現近期駭客於社交工程釣魚郵件中利用微軟 CAB 檔案作為惡意程式之散布載體。CAB 是微軟常用之壓縮封裝格式，可將多個檔案進行打包並壓縮，並廣泛應用於 Windows 更新、驅動程式及安裝程式之部署流程。惟因其具備封裝彈性與合法性，亦常遭駭客濫用以隱匿惡意內容或降低檔案特徵可見度。駭客將惡意執行檔藏匿於 CAB 檔中，以繞過安全偵測並誘使收件者點擊執行惡意內容。

- (3) 115 年資通安全，針對資安事件發現問題進行修補外，確保資安設備維持有效授權，強化郵件安全防護防禦相關策略，確認防毒軟體使用最新病毒碼及加強宣導勿下載非法軟體安裝等相關資安議題。。

民國 114 年度及截至年報刊印日止，公司並未發現重大的網路攻擊或事件，已經或可能將對公司業務及營運產生重大之不利影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。

七、其他重要事項

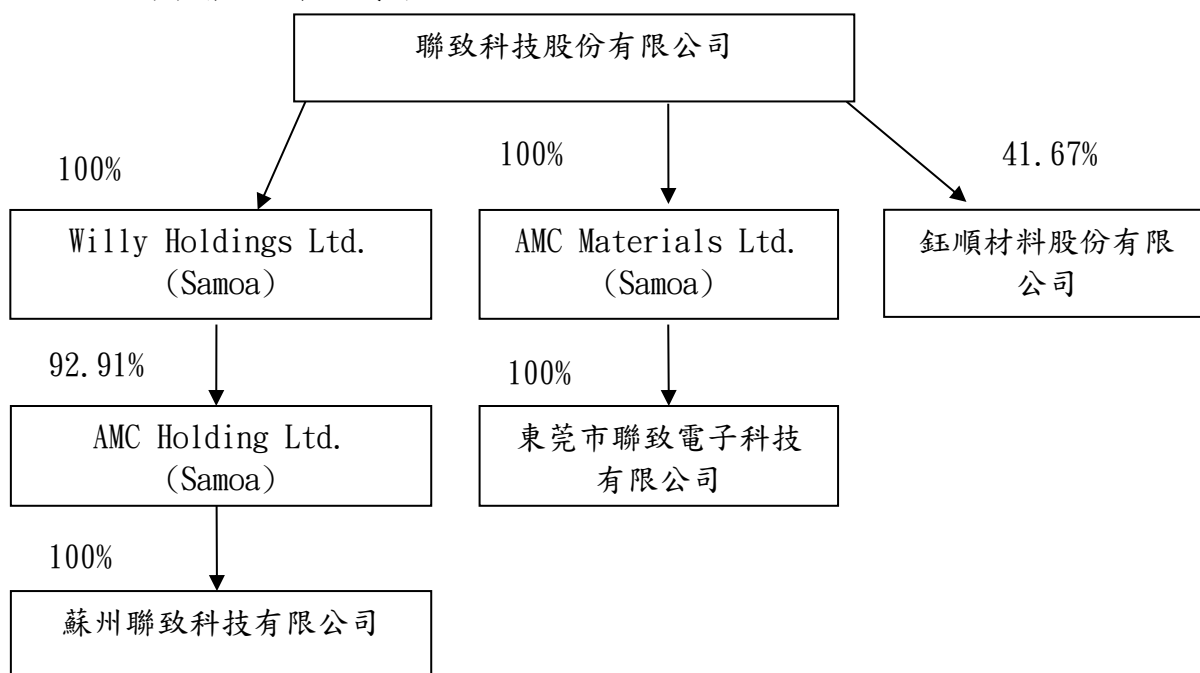
無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業概況

(1)關係企業組織圖：



(2)各關係企業基本資料

單位：新台幣仟元；114年12月31日

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
Willy Holding Ltd.	93/4/14	Samoa	US\$48,106 (NT\$1,541,833)	投資業務
AMC Holding Ltd.	94/5/4	Samoa	US\$12,658 (NT\$397,473)	投資業務
蘇州聯致科技有限公司	94/10/12	蘇州工業園區鳳里街 158號	US\$48,150 (NT\$1,539,536)	材料零售業
AMC Materials Ltd.	104/4/29	Samoa	US\$6,500 (NT\$198,329)	控股公司
東莞市聯致電子科技有 限公司	105/12/31	廣東省東莞市長安鎮宵 邊第二工業區世昌巷6 號順昌產業園B棟2樓	US\$6,000 (NT\$186,470)	材料零售業
鈺順材料股份有限公司	106/1/18	桃園市楊梅區新農街二 段209巷168號	NT\$60,000	其他化學製品零售業

(3)推定為有控制與從屬關係者應揭露事項：無。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括製造業及控股公司等。

(5)各關係企業董事長、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Willy Holding Ltd.	董事	聯致科技股份有限公司 代表人：李長明	48,106,000	100.00%
AMC Holding Ltd.	董事	Willy Holding Ltd. 代表人：李長明	12,658,375	92.91%
蘇州聯致科技有限公司	董事長	AMC Holding Ltd. 代表人：李長明	-	100.00%
	董事	AMC Holding Ltd. 代表人：曾子章	-	100.00%
	董事、總經理	AMC Holding Ltd. 代表人：陳福龍	-	100.00%
	董事	AMC Holding Ltd. 代表人：蘇連芳	-	100.00%
AMC MATERIALS Ltd.	董事	聯致科技股份有限公司 代表人：陳福龍	6,500,000	100.00%
東莞市聯致電子科技有限公司	董事、總經理	AMC MATERIALS Ltd. 代表人：陳福龍	-	100.00%
鈺順材料股份有限公司	董事長	聯致科技股份有限公司 代表人：李長明	2,500,000	41.67%
	董事	聯致科技股份有限公司 代表人：陳福龍	2,500,000	41.67%
	董事	欣興電子股份有限公司 代表人：王金勝	1,000,000	16.67%
	董事	日商互應化學工業株式會社 代表人：藤村春輝	2,500,000	41.67%
	董事	日商互應化學工業株式會社 代表人：丸澤尚	2,500,000	41.67%
	監察人	蔡永和	-	0.00%

(二)關係企業營運概況

單位：新台幣仟元；114年12月31日

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
Willy Holding Ltd.	1,541,833	392,794	0	392,794	0	(46)	(1,214)	(0.03)
AMC Holding Ltd.	397,473	421,265	0	421,265	0	(130)	(1,268)	(0.10)
蘇州聯致科技有限公司	1,539,536	333,706	0	333,706	0	(273)	(4,258)	(0.01)
AMC Materials Ltd.	198,329	129,152	0	129,152	0	(79)	(587)	(0.09)
東莞市聯致電子科技有限公司	186,470	151,844	39,928	111,916	104,122	(1,754)	(1,110)	(0.03)
鈺順材料股份有限公司	60,000	36,871	3,965	32,906	7,555	(570)	(182)	(0.03)

(三)關係企業合併財務報表及關係報告書：

本公司民國 114 年度（自民國 114 年 1 月 1 日至民國 114 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

請至公開資訊觀測站參閱本公司合併財務報告

公開資訊觀測站連結：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無。

三、其他必要補充說明事項

無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。

聯致科技股份有限公司



負責人：李長明